

LEAD FREE SOLDER PASTE

AZ 濡れ上がり特化タイプ

優れた耐熱性と濡れ上がり性を実現。
BGA未溶融などの不具合低減に効果を発揮します。

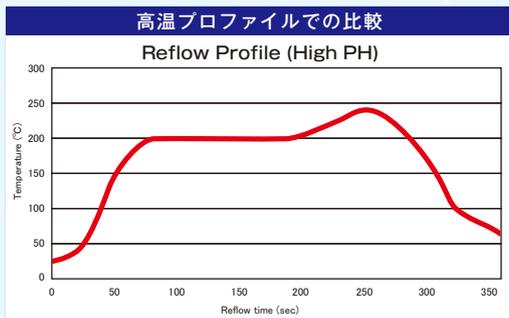
Fine Solder



Product Features 製品特性

■優れた耐熱性と濡れ上がり性

独自の活性剤技術によってソルダペーストの活性温度域を広げることで、優れた耐熱性と非常に良好な濡れ上がり性を実現しました。



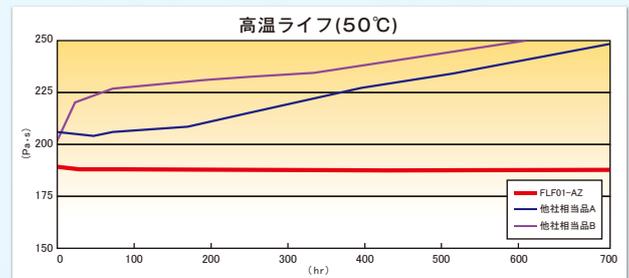
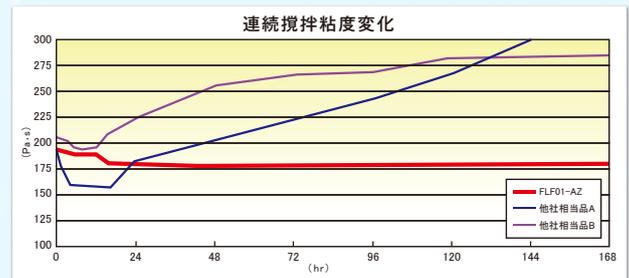
FLF01-AZ



他社相当品

■保存安定性良好

非常に安定な活性成分を使用しているため、常温におけるステンシルライフ・保管ライフに優れています。



項目	FLF01-AZ	試験規格
合金組成	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	JIS Z3282
固相線温度	約217°C	JIS Z3282
液相線温度	約219°C	JIS Z3282
はんだ粉末サイズ	20~38 μ m(Type4)	JIS Z3284(J-STD-005)
フラックス含有量	11.50%	JIS Z3197
ハライド含有量	0.00%	JIS Z3197
粘度特性	190Pa·s	JIS Z3284
チクソトロピー指数	0.56	JIS Z3284
銅板腐食試験	合格	JIS Z3197
絶縁抵抗試験(85°C 85%RH 168hr)	1.0 \times 10 9 Ω 以上	JIS Z3197
マイグレーション試験(85°C 85%RH 1,000hr)	異常なし	JIS Z3197
広がり率	88%	JIS Z3197

